

(上接A18版)

公司由博通有限整体变更设立,整体变更前公司业务流程未发生变化。公司的业务流程详见本招股意向书摘要“第三节 发行人基本情况”之“九、发行人财务会计信息及管理层讨论分析”。

(七)发行人设立以来在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变情况
公司自设立以来,在生产经营方面独立运作,除本招股意向书已经披露的内容以外,与主要发起人不存在其他关联关系和重大关联交易。上述关联关系及关联交易情况详见本招股意向书摘要“第三节 六、同业竞争与关联交易”。

(八)发行人出资资产的产权变更手续办理情况
本公司是依据《公司法》及有关法律法规的规定,于2017年3月20日由博通有限整体变更设立,博通有限的全部资产和负债由本公司依法承继。截至本招股意向书签署日,博通有限资产权属证明文件已变更至公司名下,具体情况详见本招股意向书摘要“第三节 五、公司的资产权属情况”。

三、发行人的股本情况

(一)本次发行前后的股本结构
本次发行前,公司总股本为10,403,515.00万股。本次拟向社会公众发行不超过3,467.8384万股普通股,占发行后总股本的比例不低于25.00%。本次发行后公司实际控制人不发生变更,公开发行前后股本结构如下:

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 股份性质, 发行前, 发行后. Lists shareholders like Beken BVI, 建德投资, etc.

(二)前十名股东情况

Table with 5 columns: 序号, 发起人名称, 持股数量(股), 持股比例. Lists top 10 shareholders.

(三)前十名自然人股东及在发行人任职情况

Table with 5 columns: 序号, 股东名称, 所持股份(股), 持股比例, 担任职务. Lists top 10 natural person shareholders.

(四)本次发行前股东的关联关系

截至本招股意向书签署日,公司股东安析亚、英洛安、帕康菲为员工持股平台,执行事务合伙人为艾密斯,艾密斯为公司实际控制人及其一致行动人控制的公司, Beken BVI、安析亚、英洛安、帕康菲均为同一控制下企业,自然人股东王加刚与周大为夫妻配偶关系;自然人股东徐伯维为公司实际控制人之一 Pengfei Zhang 之岳父, Beijing Integrate 与北京集成电路是同一控制下企业,鸿发投资和鸿大投资为同一控制下企业。除上述关联关系外,本次发行前股东间不存在其他关联关系。

四、公司的主营业务情况

(一)主营业务情况
公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片。公司目前产品应用类别主要包括 5.8G 产品、Wi-Fi 产品、蓝牙耳机、通用无线、对讲机、广播收发、蓝牙音响、无线麦克风等。上述产品广泛应用于蓝牙耳机、无线键盘鼠标、游戏手柄、无线话筒、车载 ETC 单元等终端。报告期内,公司主营业务未发生变化。

公司作为国内领先的集成电路芯片设计公司,经过十余年的产品和技术积累,已拥有完整的无线通讯产品方案,支持丰富的无线协议和通讯标准,为包括全球主要知名品牌在内的国内外客户提供低功耗高性能的无线数传收发和集成微处理器的无线连接系统(SoC)芯片,并为智能交通和物联网等多种应用场景提供完整的无线通讯解决方案。未来公司将基于已有的技术积累和市场化资源,充分发挥公司产品种类齐全、应用方案完善、反应速度快等优势,实现品牌价值的最大化,并布局智能交通、智能家居、智能穿戴等物联网市场,进一步巩固公司在市场和行业上的领先地位。

近年来,公司的研发团队在多个领域取得显著成绩,先后获得了上海市科技进步三等奖、上海市浦东新区科技进步二等奖、年度中国IC设计公司成就奖、年度最佳无线产品奖、年度十大中国IC设计公司品牌奖、十大最具发展潜力中国IC设计公司等奖项。同时,公司凭借优质的产品品质和服务,赢得了品牌客户的广泛赞誉,树立了良好的品牌形象,营业收入和盈利水平均保持较高水平。公司2016年、2017年和2018年分别实现营业收入52,362.28万元、56,532.15万元和54,612.01万元,分别实现净利润10,412.10万元、8,742.73万元和12,391.17万元。

近年来,随着社会经济发展和居民消费水平提高,特别是互联网和移动互联网的逐步普及,人们对无线连接的需求越来越迫切,从简单的控制命令的无线传输,到高保真的音频信号的无线传输,甚至到高清晰度的视频信息的无线传输,无线通信已经进入飞速发展的阶段。与此同时,无线领域相关的国际标准和协议不断完善,相关技术和产品也因此得到了持续的快速发展。公司作为国内领先的无线通讯集成电路芯片设计公司,长期专注于研发设计高集成度、低功耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品,产品种类丰富,应用领域广泛,覆盖了从智能交通、智能家居、计算机外设等多个领域。

公司的主要产品划分为无线数传类、无线音频类芯片,基本情况如下:

Table with 3 columns: 产品大类, 应用分类, 主要终端产品. Lists products like 5.8G products, Wi-Fi products, etc.

1. 无线数传类芯片

无线数传类产品作为智能设备互联互通必不可少的关键部件,帮助实现智能家居设备之间的互联互通,让不同智能设备相互协作。随着物联网的发展和无线数传类芯片的广泛应用,无线数传类芯片,将具备广阔的市场前景。

无线数传类芯片采用无线通讯的方法实现数据传递和接收,公司产品主要包括独立的射频收发器、集成微处理器(MCU)的无线微控制器,符合国家标准的超高速公路不停车收费(ETC)芯片组,以及支持完整通讯协议和安全协议的低功耗蓝牙(BLE)、传统蓝牙(BT)芯片等。

公司无线数传类产品主要应用于高速公路不停车收费(ETC)、无线键盘鼠标、遥控手柄和无人机飞控等领域,终端客户覆盖了包括金溢科技、雷柏科技、大疆科技等国内知名企业。

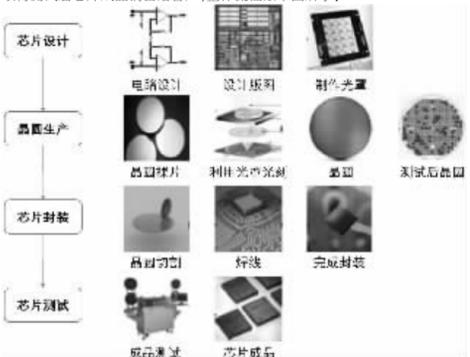
2. 无线音频类芯片

无线音频类芯片采用无线通信的方法实现音频信号的传递和接收,包括独立的射频收发器、集成音频信号采集、播放、编解码的无线音频系统芯片(SoC),集成经过标准化认证的音频编解码器,集成音频信号采集、播放、编解码的标准协议的音频蓝牙芯片和多款 CMOS 集成音频芯片产品等。

公司无线音频类产品主要应用于收音机、对讲机、无线麦克风、无线多媒体系统、蓝牙耳机、蓝牙耳机和智能穿戴等领域,终端客户包括摩托罗拉、LG、夏普、飞利浦和阿理巴巴等。

(三)主要经营模式
公司的主要经营模式为 Fabless 模式,即“没有制造业务,只专注于设计”的一种经营模式。采用该种经营模式的公司只从事产业链中的集成电路设计和销售环节,其余环节委托给晶圆制造企业、封装和测试企业代工完成,公司

取得测试后芯片成品销售给客户,整体流程如下图所示:



1. 研发模式
公司的主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售,以 Fabless 模式为主要经营模式,因此产品设计及研发环节属于公司经营的核心流程,由研发中心具体执行,公司的研发中心下设系统设计部、数字设计部、射频模拟部、版图设计部、软件开发部、应用和方案部、技术支持部等七大部门,分工明确,相互协作。多年来,公司形成高度规范化的研发流程和质量管理体系,并根据实际执行情况不断的完善和更新,全面覆盖产品开发立项、产品设计、样品试产、量产推广等阶段,确保每项新产品研发的质量、风险、成本均得到强而有效的管控。公司产品的研发流程如下图所示:



(1) 立项阶段

公司研发中心会结合市场分析、产品技术创新需求和目标客户新增需求,进行新产品开发提案,并随后组织对新产品的市场定位、功能定位、技术路线、知识产权、成本、盈利前景进行可行性研究,完成《可行性评估报告》,以保证拟开发的产品符合市场需求且具备市场竞争力。期间,研发主管会同总经理、业务及运营主管对项目可行性研究结果进行评审。立项后,研发中心安排项目负责人,并根据客户需求制定研发项目计划,确定详细的技术规格、技术指标,系统软硬件方案和项目进度安排,细化系统设计、电路设计、版图设计、样品生产等阶段的任务分工及进度要求,最终形成合理的产品开发计划。

(2) 研发阶段

研发中心将根据产品开发计划的方式和要求制定进度安排开展工作,以召开项目周会和项目协调会的方式,组织解决研发过程中遇到的问题,协调跨部门资源,保证项目研发工作的实施。公司在研发过程的各个环节均设置了严格的质量检测标准,如发现产品设计存在缺陷,则需项目负责人协调人员查明原因并提出相应修改方案,直到符合质量检测标准为止。在完成整个研发阶段后,经总经理审批后,可进入样品试生产环节。

(3) 样品试产阶段

样品试产阶段中,研发中心委托晶圆代工厂、封装测试厂依照与量产流程相同的流程进行样品试生产,样品完成后,研发中心会组织对其进行严格的评估测试,以确认产品满足可用性、可靠性、可扩展性、完整性等要求。随后市场人员将样品提供给目标客户进行试用,由客户的技术研发团队对新产品的功能的应用性进行测试,如在应用方面存在缺陷,需重新返回产品设计阶段。如产品各项指标均符合要求,则经过总经理审批后可进入量产阶段。

(4) 量产阶段

新产品需通过公司销售中心和下游各经销商进行推广,公司根据在手订单和潜在需求对未来 3-6 个月内的新产品需求进行预估,根据预估安排生产计划和交货进度。完成产品交付后,公司安排专人定期提供技术支持与维护工作,及时解决客户反馈的问题。

2. 采购模式

在 Fabless 模式下,公司专注于集成电路的设计,而芯片的生产制造、封装测试则委托委外方式完成,因此公司需要向晶圆制造厂采购晶圆,向封装测试厂采购封装、测试服务。目前公司的主要晶圆制造厂为芯志国际、华虹宏力等,主要封装测试厂为长电科技、杭州朗讯、南通富士通、台湾久元和台湾全智等。

(1) 供应商的选择
在开发阶段,公司经由网络、期刊杂志、展会及相关人士咨询等手段,获取供应商信息并进行初步筛选,要求供应商填写《供应商基本资料表》,并提供营业执照及质量体系认证等证书。公司会根据需要对供应商提供的产品参数或样品质量进行确认。

在评估阶段,公司选择供应商主要考虑经营状况、质量管理、生产能力、技术能力、业务配合、价格水平等多个评估因素。具体来说,公司会对供应商的业务经营范围、市场占有率及诚信状况进行评估;了解供应商的质量管理体系是否完善,判断供应商的设备和产能状况能否满足公司产品生产的需求;判断供应商在新工艺和新产品的支持开发和解决问题的能力;评价供应商售后服务窗口的技术水平和反应速度;综合对比同类供应商的市场价格水平以及价格调整政策是否合理等。

对于晶圆制造,由于该类公司业务导向性强,集中度高,产业特性,同时从事晶圆代工行业具有较高门槛,必须具备较强的研发能力、品质保证能力、较大的生产规模及丰富的生产经验,公司主要的供应商华虹宏力和芯志国际,均拥有成熟、稳定的生产工艺,其产品的良率和一致性也保持行业内领先水平。

对于封装测试,公司会综合考虑各项评估指标,选择境外最为符合要求的供应商进行合作,境内如长电科技、杭州朗讯等,境外如台湾久元、台湾全智等。

公司与各供应商之间保持了长期稳定的合作关系,一方面有利于各供应商对公司的各种需求进行快速有效的反馈,形成稳定的采购合作模式,同时也使供应商的产能得到充分利用,另一方面有利于提高产品开发过程中解决问题的效率和响应速度,提升产品的可用性和可扩展性。

(2) 采购流程

1) 采购流程:销售中心定期同生产运营部召开产销会议,由销售中心提出最近 3-6 个月的销售计划,其中包括公司在新的产品的出货计划(时间/数量)、安全库存数量,以及紧急需求提出,生产运营部在产销会议上提供各产品的库存和在制品数量,与销售中心共同进行供需分析,如发现供货不足,则分析需求数量,并汇总记录《产销会议记录》作为请购依据并留档备查,生产运营部根据《产销会议记录》编制《晶圆生产请购单》和《芯片封装请购单》,交部门主管审核。审核通过后,交由由采购人员进行采购。

2) 采购流程:采购人员接到请购单后,向销售中心和生产运营部对规格、数量、产品规格、加工要求、需求日期等采购信息进行确认。确认无误后,采购人员与两家以上的供应商进行价格商榷,结合品质、交期、服务、付款方式等方面要求,将询价、比价、议价的结果呈报部门主管核准。若采购项目为特定技术或特殊制程限制而具有唯一供应商时,可免于询价、比价、议价流程。

如为委外加工采购,生产运营部会根据产品出货时间和数量需求,详细咨询委外加工商的生产是否能够满足生产计划的需求,并结合加工价格和品质因素以及以往生产记录选择供应商。采购人员需及时对《生产采购价目表》进行维护,根据核准的《晶圆生产请购单》或《芯片封装请购单》于 ERP 系统开立相应的“委外加工订单”,并经部门主管核准后,将上述采购单发送到供应商处。经供应商确认后,采购完成,转入生产循环,由生产运营部负责流程跟踪。生产采购进度由生产运营部负责跟踪,采购人员应定期同生产运营部确认“委外加工单”的执行情况,以免发生有订单无加工的情况。

如为一般采购,采购人员在《合格供应商列表》中选择两家以上供应商进行询价、比价、议价,根据采购项目的数量和性质,从中挑选在品质、交期、服务和商务等方面符合要求的供应商。采购人员提交《物品/非生产采购》申购单,经核准后,直接由相关采购人员与供应商约定交付日期(完成采购)。根据供应商提供的交期进行跟踪,以免发生有订购而无供货或交货时间过长的情况。

3) 验收流程:

如为委外加工验收,验收员依据公司《供应商管理办法》规定,由供应商代为进行品质检验,经研发人员确认后,转入量产测试,最终判定为合格的产品,方可入供应商成品库库存或由生产管理部门安排发货。供应商需定期向质量管理人提供相关测试报告,作为监控记录。委外加工成品出库的数量和地点由生产运营部统一安排,收货方依照供应商提供的出库单对所收货品进行点收,确认收货信息正确后,于系统中生成相应的“入库单”。

如为一般采购验收,收货后由采购人员通知请购部门进行点收,核对相关文件,确认产品规格及数量,经使用人确认后质量符合采购要求,由请购人员签字确认。采购人员收到请购部门验收合格后,完成《请款单》,连同《物品/非生产原料》申购单》及供应商提供的发票进入付款流程。验收有异常时,由请购部门通知采购人员联系供应商做退货或做重工处理。

3. 生产模式

公司产品设计到上市主要经过样品试产、样品改进、批量生产三个环节。

(1) 样品试产阶段:由研发中心在完成产品设计后将版图交与晶圆制造企业,由生产运营部负责与晶圆制造、封装、测试相关企业进行商务沟通和投产安排,晶圆制造企业根据设计版图进行样品流片,试生产完成后再次与封装和测试企业进行封装测试,完成样品生产。

(2) 在样品试产阶段,销售中心与研发项目组提交试用和评测意见,项目组根据样品测试结果调整产品设计与代工工厂提供生产测试流程,不断提高产品质量和生产工艺水平,直到达到最终量产要求。

(3) 在批量生产阶段,产品量产由申请审批通过后,生产运营部根据市场需求,晶圆生产周期和合理的存货水平确定采购量,向代工企业下达订单进行批量生产。在生产过程中,公司会向代工企业获取生产进度报告,跟踪生产进度,加工完成并经过检测后,公司会将晶圆送至封装与测试厂封装测试,并将测试合格后的芯片产品入库。

(2) 委外加工采购

1) 委外加工物资明细如下表所示:

Table with 5 columns: 内容, 2018年12月31日, 2017年12月31日, 2016年12月31日. Lists materials like 委外加工物资-原材料-无线数传类, etc.

2) 委外加工的定价依据

公司需要向晶圆制造厂采购晶圆,以及向封装测试厂采购封装、测试服务。采购价格均参照行业内平均价格,并根据当时市场环境协商决定。晶圆制造采购的定价主要考虑:晶圆的尺寸大小、制造工艺的精密程度、同种工艺下的不同光源材料选项和具体光源型号等。公司每年末会与主要晶圆供应商对于下一年的采购情况进行沟通,并结合公司销售的产品情况就相关原材料的采购价格进行商议,协议降低相关晶圆的采购价格。

封装测试采购的定价主要考虑:封装应用的类别、封装产品的主要材料清单、产品测试时间的长短和测试机台的应用,不同供应商的同种封装形式进行比价等。封装测试方面,公司会定期和主要的封装测试供应商进行沟通,结合采购量和市场销售情况,协商降低封装测试的采购价格。

3) 公司与委外供应商的合作关系
稳定的供应链体系对集成电路设计公司具有重要意义,通常情况下,晶圆制造厂和封装测试厂一旦进入公司合格供应商资质清单,便可纳入公司长期的供应链体系中,并逐步发展与其建立更深层次的合作关系,一般而言不会轻易更换。

同时,公司与各委外加工厂商合作时间长,建立了长期稳定的合作关系,随着公司规模的不断扩大,各晶圆制造厂和封装测试厂也同样需要吸引公司这种优质良材,采购稳定且具有一定行业影响力的集成电路设计公司合作,因此公司对委外加工具有越来越强的议价能力。

4. 销售模式

公司销售采用“经销为主、直销为辅”的销售模式,公司与经销商的关系属买断式销售关系,即公司将商品销售给经销商后,商品的所有权即转移至经销商,通过该销售模式可以使公司更好的专注于产品的设计研发环节,提高产业链各个环节的效率。报告期内公司通过经销模式实现的销售收入占主营业务收入的 90%以上,占比保持稳定,且未来该销售模式不会发生重大变化。

(1) 经销流程

1) 制定销售计划:销售中心依据行业市场信息、同业信息及公司在往年经营的实际业绩并结合公司销售状况,同时考虑公司新产品开发计划,公司的市场优势劣势,外在的竞争机会及威胁,自身资源,拟订公司未来一年的营业目标,并制订销售策略及方针,呈总经理核阅。各部门定期召开产销会议提供未来三个月的销售数据,并作为生产运营部投产参考的数据,生产运营部依据汇总确认后的销售计划安排投产且跟踪生产。

2) 订单处理:销售人员接获客户询价后,依《产品价格表》视客户需求提供销售中心核准后的报价单,运营助理负责每月末对《产品价格表》进行维护,正式接获客户订单后,检查订单所有内容是否齐全,根据库存情况与生产运营部讨论可达成的交期,在取得确认后对客户订单进行回复。

3) 发货处理:对交易条件为货到付款的客户,生产运营部确认收到客户的付款水单后方可发货,对于授信客户,则在授信条件下发货,若客户授信条件不足或尚未办妥授信程序,仍需要发货的,需销售中心填写《超授信发货申请单》,申请审批流程,经部门主管核准后,安排客户提货。

4) 开票及收款:销售发票由 ERP 系统(发货单)自动生成,由部门主管根据订单和出货记录审核,寄送给客户。财务部在收到客户的汇款通知单或票据时,由运营助理确认款项,经部门主管审核后,完成账务处理。财务部根据每月银行对账单,核对银行余额与帐列数是否相符。

(2) 经销商的作用

集成电路设计企业的通常采用经销为主、直销为辅的销售模式,经销商是集成电路产业链中重要、不可或缺的角色,是上下游产业的联系纽带。具体作用体现在以下几个方面:
1) 快速拓展多年的市场经营,积累了一定的客户资源,能够协助集成电路设计公司更有效的拓展市场,使公司开发的芯片与终端应用客户的产品快速结合,尤其面对客户众多、规模不一、需求千变万化、订单较为零散的市场,利用经销商优秀的客户拓展能力,能高效地完成产品营销,而集成电路设计公司自身拥有较大的市场推广团队则并不经济。对于新产品,通过经销商销售能具有较大的市场,缩短了新产品市场推广的时间,能够高效、快速的占领新兴市场,节约集成电路设计公司市场推广费用。

2) 加强高效的对客户维护及售后服务
部分经销商具备一定的方案解决能力,能够为终端客户提供完整解决方案,降低客户产品开发成本和生产制造成本,支持终端客户加快研发进程,优化产品,提高产品竞争力,尤其对于产品种类多样,应用面广,客户数量较多的集成电路设计公司,经销商能够更快更有效的提供售后服务,更便捷的有效的满足终端客户需求,提供本地化支持。

3) 促进经销商设计企业的运营效率,提升核心竞争力
经销商能够更有效的协助集成电路设计公司完成市场的开拓、客户维护、售后服务等产品的销售的一系列重要工作,使得集成电路设计公司能够将更多的人力、资金投入产品的研发中去,开发出更优秀的产品,快速提升集成电路设计公司的核心竞争力。

5. 盈利模式

公司通过委外加工方式取得芯片成品后再销售给下游经销商或终端客户获得盈利。单一产品生命周期随产品生命周期波动,通常而言,新产品刚面世时,价格较高,毛利率维持在较高水平;随着生产规模的扩大,价格相应下降,毛利率出现下降趋势,直到产品更新换代时,毛利率回到较高水平,维持整体利润空间。为保障盈利能力,公司将重点关注以下几点:

(1) 技术创新拓宽品类,有效降低研发成本

技术创新是公司立足之本,也是公司拓展全新产品品类,提升公司业务规模的重要因素。通过技术创新,公司不仅可以为客户提供满足客户要求的产品和解决方案,还可以在行业内建立先发优势,对客户需求起到引领作用。同时,公司模块化的研发流程有效缩短了新产品的研发周期,提升响应速度,降低研发成本,最终有利于形成性价比的产品价格体系,维持稳定的利润空间。

(2) 产业链优化配置

公司与知名的晶圆制造厂、封装测试厂和经销商形成长期合作关系,确保公司在产品和下游一定程度的支持,专注于集成电路设计领域,巩固行业领先地位,提升市场占有率,实现全产业链协同效益最大化。

(3) 产品更新换代提升盈利能力
集成电路设计行业中单一产品的毛利率水平往往伴随其产品生命周期形成一定波动,公司在不断推进技术升级的同时,会推动产品增加功能的多元化程度和更新换代速度,引导市场需求,提升盈利能力。

(四) 公司销售情况

1. 主营业务收入分产品构成

报告期内,公司销售收入及占比分产品情况如下:

Table with 6 columns: 产品应用, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists applications like 无线数传类, 5.8G产品, etc.

2. 主要产品销售情况

公司自身从事生产活动,通过对未来 3 个月的市场预测情况进行预估,通过委外加工的方式完成订单的生产安排,报告期内公司主要产品的产销情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists products like 无线数传类, 无线音频类, etc.

3. 主要产品销售价格情况

报告期内,公司无线数传和无线音频类芯片产品平均价格情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists average prices for 无线数传类, 无线音频类, etc.

4. 公司销售的区域分布

报告期内,公司主要产品区域销售情况如下:

Table with 6 columns: 地区, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists regions like 大陆, 台湾, 香港, etc.

5. 公司销售模式构成

报告期内,公司按销售模式分区的销售情况如下:

Table with 6 columns: 地区, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists sales modes like 直销, 经销, etc.

6. 报告期内前五大客户销售情况

报告期内,公司向五大客户销售情况如下:

Table with 6 columns: 年份, 序号, 客户名称, 是否为经销商, 不含税金额(万元), 占比. Lists top 5 customers for 2018, 2017, 2016.

注:

1. Synstar (SZ) Technology Co., Limited, HongKong Belon Technology Co., Ltd., 深圳博芯科技股份有限公司为同一控制下企业,因此合并计算为博

芯;

2. 无线大国际(香港)有限公司、深圳市芯志中芯科技有限公司、Yongsheng Technology (HK) Co., Ltd. 为同一控制下企业,因此合并计算为芯志中;

3. 深圳市瀚威德科技有限公司、Rodintech Holdings Limited 为同一控制下企业,因此合并计算为瀚威德;

4. HKT Electronic Technology Co., Ltd. 深圳市宏科特电子科技有限公司为同一控制下企业,因此合并计算为宏科特;

5. 深圳市集策科技有限公司、Gather Genius Technology (HongKong) Limited, Universal Ascent Holdings Limited 为同一控制下企业,因此合并计算为集策;

6. Gateway Tech Company Limited、深圳聚波达科技有限公司为同一控制下企业,因此合并计算为聚波达;

公司与主要经销商的合作情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 客户名称, 经销产品, 开始合作时间. Lists distributors like 芯志中, 博芯, etc.

注:

1. Synstar (SZ) Technology Co., Limited, HongKong Belon Technology Co., Ltd., 深圳博芯科技股份有限公司为同一控制下企业,因此合并称为博芯;

2. 无线大国际(香港)有限公司、深圳市芯志中芯科技有限公司、Yongsheng Technology (HK) Co., Ltd. 为同一控制下企业,因此合并称为芯志中;

3. 深圳市瀚威德科技有限公司、Rodintech Holdings Limited 为同一控制下企业,因此合并称为瀚威德;

4. HKT Electronic Technology Co., Ltd. 深圳市宏科特电子科技有限公司为同一控制下企业,因此合并称为宏科特;

5. 深圳市集策科技有限公司、Gather Genius Technology (HongKong) Limited, Universal Ascent Holdings Limited 为同一控制下企业,因此合并称为集策;

报告期内,公司采用经销为主、直销为辅的销售模式,与各大经销商合作情况良好。由于各经销商均在业内积累了一定的客户资源,并能协助集成电路设计公司有效地拓展市场,因此公司向五大客户销售金额较大且集中度较高,符合行业特性。

报告期内,随着公司规模不断扩大,公司主要经销商采购金额有所增加,同时公司在向本客户采购后,对于部分产品,还需进行简单加工、烧录程序代码或组装为模组,以提供完整方案给终端客户,公司与主要经销商均保持了较长时间的合,报告期内,公司的主要经销商保持稳定,公司对单一客户不存在重大依赖。

(五) 主要产品的供应情况

1. 主要原材料采购及能源供应情况
公司专注于集成电路的设计,而芯片的生产制造、封装测试则通过委外方式完成,其中硅片晶圆的生产由晶圆代工厂完成,而芯片的封装测试由封装厂完成。由于公司不直接从事生产活动,不采购生产所需的能源。

2. 公司采购构成情况

公司报告期内采购构成情况如下:

Table with 5 columns: 项目, 2018年度, 2017年度, 2016年度. Lists procurement items like 晶圆材料成本, 封装和测试, etc.

报告期内,公司采购主要内容包含晶圆制造、封装和测试,通常情况下,公司根据在手订单和潜在需求在未来 6 个月内的新产品需求进行预估,根据预估结果及市场采购提前进行采购。报告期内,晶圆供货时有紧张,因此公司采购情况有所波动。

2016年底,原材料晶圆产能较为紧张,公司为保持供货稳定性,加大了采购力度,因此采购金额有所增加。2017年公司采购额较2016年度有所下降,主要原因系2016年公司备货较为充足,管理层根据库存情况和需求调整了2017年的晶圆生产计划和封装测试生产计划所致。2018年公司应对市场,主动进行备货,导致公司2018年采购额2017年有所上升。

3. 报告期内前五大供应商采购情况

报告期内,公司向前五供应商采购情况如下:

Table with 6 columns: 年份, 序号, 供应商名称, 采购内容, 不含税金额(万元), 占比. Lists top 5 suppliers for 2018, 2017, 2016.

注:

1. 上表中芯志中芯志集成电路制造有限公司采购的不含税金额为博通集成向其上海子公司、北京子公司和天津子公司采购的合计数;

2. 联华电子股份有限公司采购的不含税金额为博通集成向其台湾公司、新加坡子公司采购的合计数。

报告期内,公司与各大晶圆制造厂和封装测试厂合作情况良好。由于晶圆制造厂和封装测试厂属于资本和技术密集型行业,符合供应商条件的厂商较为有限,因此公司向前五供应商采购金额较大且集中度较高,符合行业特性。公司向单一供应商采购金额占比均未超过 50%,因此,对单一供应商不存在重大依赖。公司向主要供应商为行业内知名企业,采购价格符合市场标准。所有供应商均不存在不具备生产资质与进行交易的情形。

公司结合行业特性和自身特点,联合生产运营、稽核、研发等多个部门共同制定了供应商相关的内部控制相关文件,努力提高公司长效解决机制等制度建设,确保公司的供应商选择,品质管控,争议解决等问题得以落实。报告期内,公司主要供应商的合作关系良好,公司于采购及供应商管理、生产运营流程、产品质量保证、核心技术保密的等方面的相关内控制度健全,且相关制度均得到有效执行。

公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员以及主要关联方或持有公司 5%以上股份的股东不存在在上述供应商中占有权益的情形。公司主要供应商芯志国际持有芯志瀚威股权投资管理有限公司 30%股份,芯志瀚威股权投资管理有限公司持有上海瀚威股权投资管理合伙企业(有限合伙) 70%股份,上海瀚威股权投资管理合伙企业(有限合伙)为持有公司 1.80%股份股东聚源聚兴的普通合伙人。

五、公司的资产权属情况

1. 固定资产情况

截至2018年12月31日,公司固定资产情况如下:

Table with 6 columns: 项目, 折旧年限(年), 原值, 累计折旧, 减值准备, 账面价值, 成新率. Lists fixed assets like 房屋及建筑物, 办公、电子设备及其他, etc.

2. 房屋建筑物

截至2018年12月31日,发行人具有以下房屋所有权及土地使用权:

Table with 6 columns: 序号, 所有权人, 房产坐落, 坐落位置, 建筑面积(m²), 规划用途, 取得方式. Lists real estate properties.

注: 1. 发行人房屋所有权证统一编号为不动产权证书的原因,故发行人房屋所有权证书变更方式为不动产权证书。发行人房屋所有权及土地使用证编号、权利人姓名、用途、面积、使用期限等其他信息不变。

截至2018年12月31日,发行人租住房屋的具体情况如下:

Table with 6 columns: 序号, 承租方, 出租方, 坐落位置, 建筑面积(m²), 用途, 租赁费用(元/月), 租赁期限. Lists leased properties.

(二) 无形资产

1. 主要无形资产情况

截至2018年12月31日,公司无形资产账面金额如下:

Table with 6 columns: 项目, 取得方式, 摊销年限, 账面原值, 累计折旧, 账面价值. Lists intangible assets like 特许经营权及软件, 外购, etc.

报告期内,公司与 Synopsys、Riviera、Waves、S.A.S、CEVA、D.S.P.Ltd、Cadence Design Systems (Ireland) Limited 等公司签署了许可协议或采购协议,对公司研发过程中使用的软件及技术许可进行购买,并按照协议支付相关费用。

(1) 商标

截至2018年12月31日,公司拥有注册商标共3项,具体如下:

Table with 4 columns: 序号, 商标名称, 注册号, 有效期. Lists trademarks like 博芯, 瀚威德, etc.

(下转A20版